

深圳市江波龙电子股份有限公司

2026 年半年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形

单位：万元

项 目	本报告期			上年同期
归属于上市公司股东的净利润	920,000	~	1,100,000	1,476.63
	比上上年同期增长 62,204.03%	~	74,393.95%	
扣除非经常性损益后的净利润	900,000	~	1,050,000	3,220.69
	比上上年同期增长 27,844.32%	~	32,501.71%	
营业收入	2,200,000	~	2,500,000	1,019,565.54

注：本表格中的“万元”均指“人民币万元”。

二、业绩变动原因说明

1、报告期内，受下游需求增加以及全球存储晶圆产能总体增长有限的影响，全球半导体存储产业景气，为公司创造了良好的外部环境。同时，公司与多家全球主要存储晶圆原厂顺利续签晶圆供应协议（LTA 或 MOU），保障了存储晶圆的供应，为未来的长远发展夯实了资源基础。

2、报告期内，公司以自研芯片（如 SPU 主控芯片）、自研软件架构（如 HLC 等）为技术引领，以自有高端封测产能作为关键落地支撑，系统支撑端侧 AI 存储多元综合需求，全面拥抱端侧 AI。其中，公司与 AMD 完成联合调优，实现公司 SSD 存储智能体和 HLC 技术支持端侧 AI 产品 DRAM 使用量下降 40%

左右的技术创新。

三、其他相关说明

- 1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步核算的结果，未经审计机构审计。
- 2、2026年半年度业绩的具体数据将在公司《2026年半年度报告》中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

四、备查文件

- 1、董事会关于本期业绩预告的情况说明；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市江波龙电子股份有限公司董事会

2026年7月3日